

INVESTOR RELATIONS 2019

Better Life with Telechips



Smart Car

Telechips

Smart Home



Telechips



본 자료는 투자자의 투자를 권유할 목적으로 작성된 것이 아니라 투자자의 이해를 증진시키고 투자판단에 참고가 되는 각종 정보를 제공할 목적으로 작성되었으며, 본 자료를 작성하는데 있어 최대한 객관적인 사실에 기초하였습니다. 그러나 현 시점에서 회사의 계획, 추정, 예상 등을 포함하는 미래에 관한 사항들은 실제 결과와는 다르게 나타날 수 있고 회사는 제반 정보의 정확성과 완전함을 보장할 수 없습니다. 따라서 본 자료를 참고한 투자자의 투자의 사결정은 전적으로 투자자 자신의 판단과 책임하에 이루어져야 하며, 당사는 본 자료의 내용에 의거하여 행해진 일체의 투자행위 결과에 대하여 어떠한 책임도 지지 않습니다. 따라서 본 자료는 어떠한 경우에도 투자자의 증권투자 결과에 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.



Better Life with Telechips

INVESTOR RELATIONS 2019

Table of Contents

- I . Corporate Identity
- II. Market Trend & Biz. Strategy
- III. Investment Highlights
- IV. 2019 1Q Review
- #Appendix

국내 No.1 지능형 시스템 반도체 개발 전문 기업

차량용 반도체 원천기술 보유

핵심기술의
우수성

국내 차량 반도체 No.1
국내 유일의 셋톱박스 반도체 기업

국내 시스템반도체
분야 선도기업

지능형 반도체 개발 통한
미래성장동력 선도 및
글로벌 기업으로의 성장

비전

카 인포테인먼트 세계 3위
스마트 셋톱박스 세계 3위

안정적
재무구조

무차입경영 실현

지식
재산권

총 153개의 국내외
특허 보유

업계 최고의
연구개발 투자

3개년('16~'18) 평균
연구개발비 비중
30%

글로벌
이노베이터

개발 협력사, 고객사 등
국내외 협력 네트워크 보유
300개 이상

“Application 통합된 Smart Cockpit Solution 확대”

Multiple Display Trend



2010

Digital Cockpit



2015

Connected Car



2020

Consolidation



2025

HMI for
Autonomous

- ✓ 고성능 CPU/GPU 지원 차량용 반도체
 - ✓ 다중 디스플레이 및 멀티OS 지원 차량용 반도체
- AVN, Digital Cluster, HUD, RSE,
E-mirror, Passenger Monitor

Automotive 응용시장 확대 (Multi Growth Pipeline)



Surround View Monitoring



Consolidation



Head-up Display



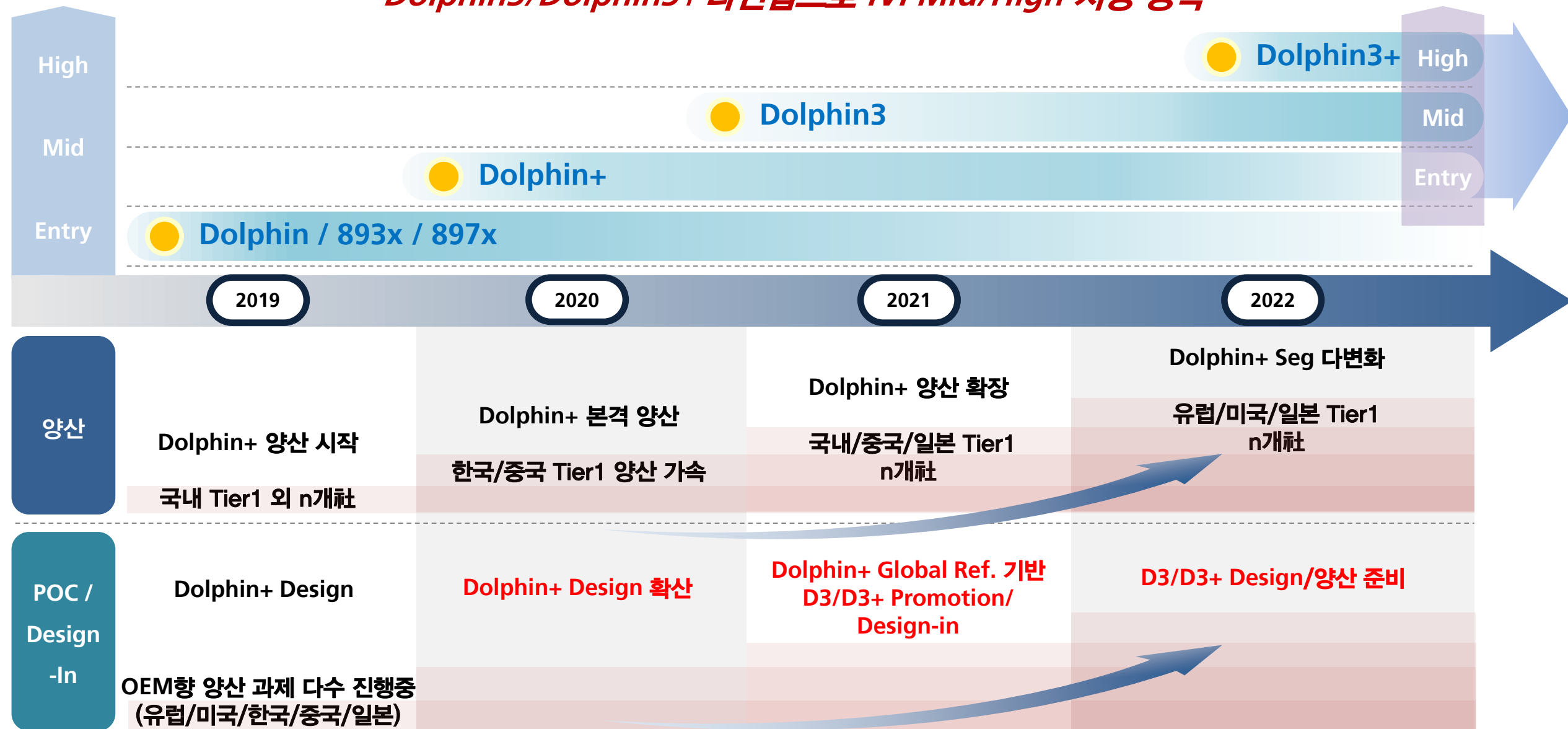
Full Digital Cluster



Telematics

Automotive 고객사 확장 추진 현황

“Dolphin3/Dolphin3+ 라인업으로 IVI Mid/High 시장 공략”



Smart Home 시장 및 고객사 확장 추진 현황

“Value Added Feature(UHD CAS / Android TV)확보를 통한 Mid/High Market 공략”

High



Performance Driven Market

Mid



Cost Driven Market

Low



HISILICON

TeleChips

- ✓ Synamedia 4K CAS 인증 획득 (W/W Broadcom과 유이한 인증기업)
- ✓ Google Android TV Approved SoC Partner

프로모션
현황

- 국내 IPTV社 양산 과제 및 PoC진행 (KT, SKBB)
- 동남아시아 및 유럽 방송사업자향 Android TV 양산 과제 프로모션 진행 중
- Synamedia CAS/CDI 기반 유럽/동남아/중동사업자 Linux 과제 프로모션 진행 중
- 미주 대형 통신사업자 IP/OTT 과제 프로모션 진행 중

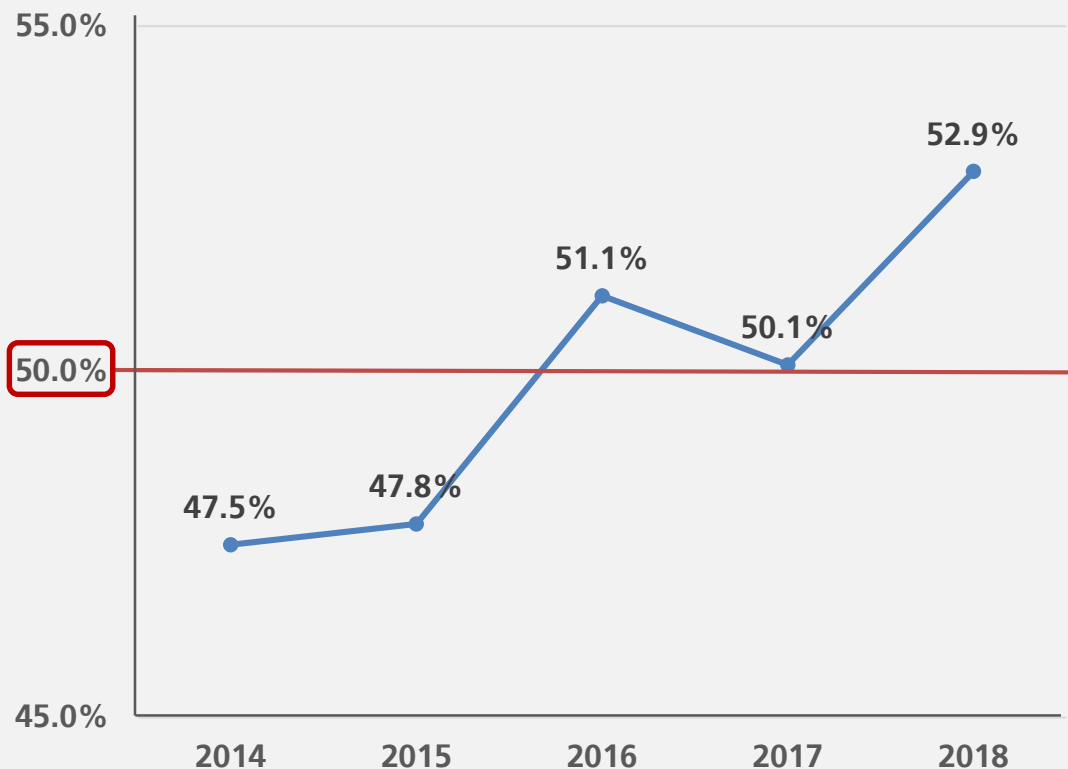
고객다변화 및 응용시장 확대로 지속 성장기반 구축



매출 증가 및 수익성 개선을 통한 영업 레버리지 효과 기대

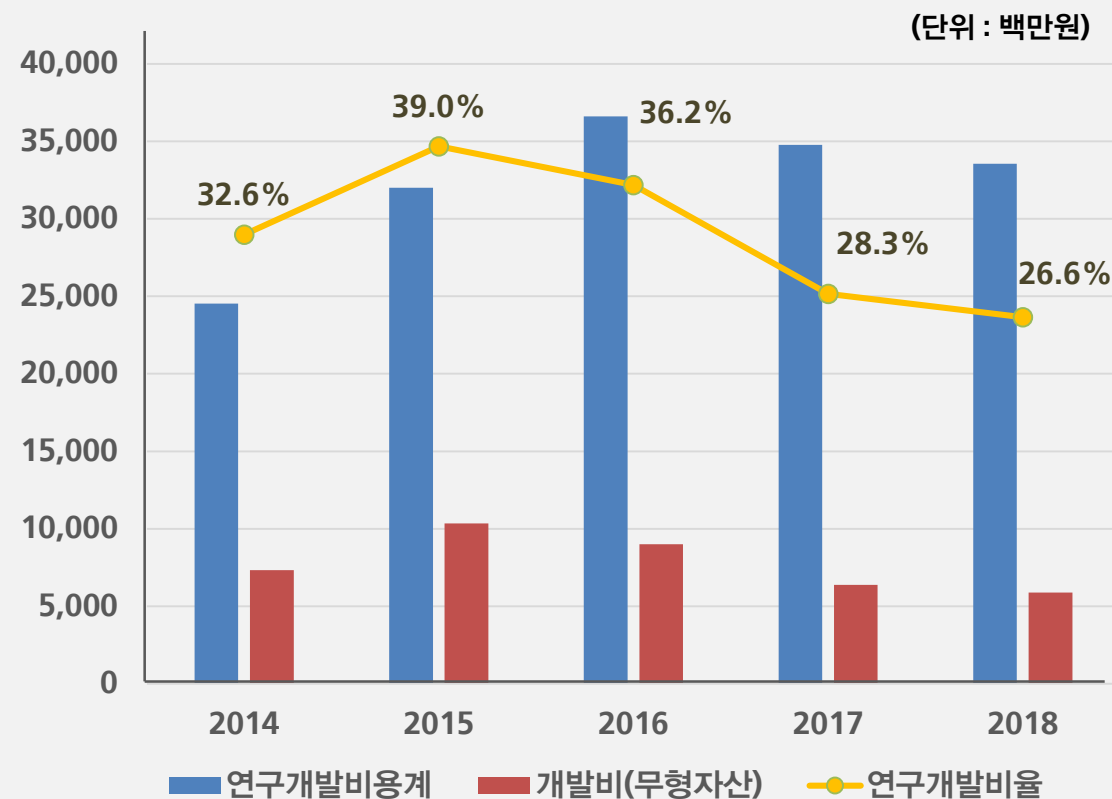
“Product Mix 개선을 통한 판매 마진을 향상”

최근 5개년도 판매 마진을 추세

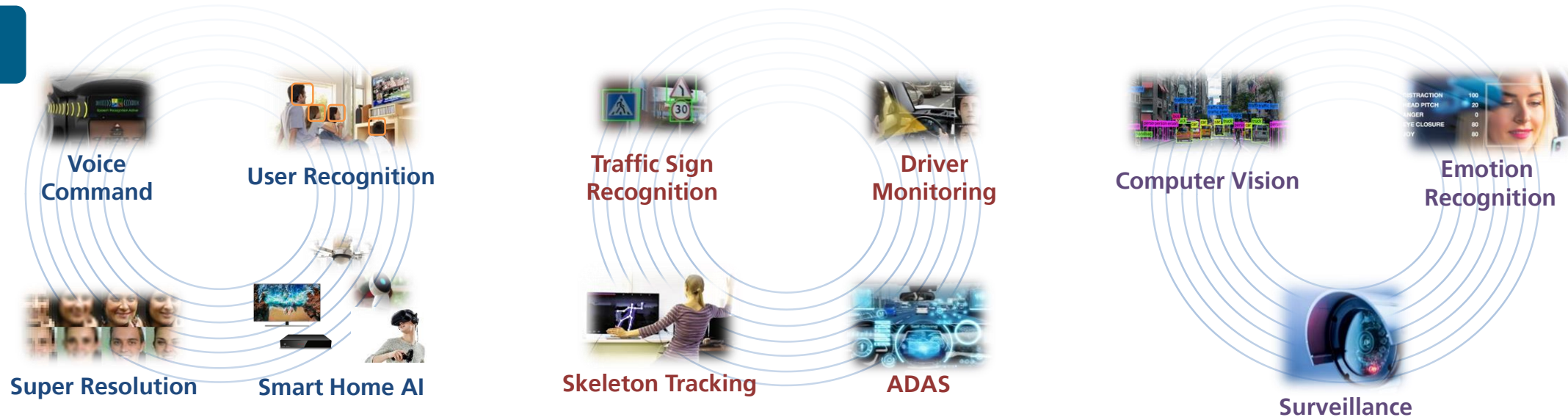


“선택과 집중을 통한 R&D 투자 효율화”

최근 5개년도 연구개발비 현황



Solution



SoC

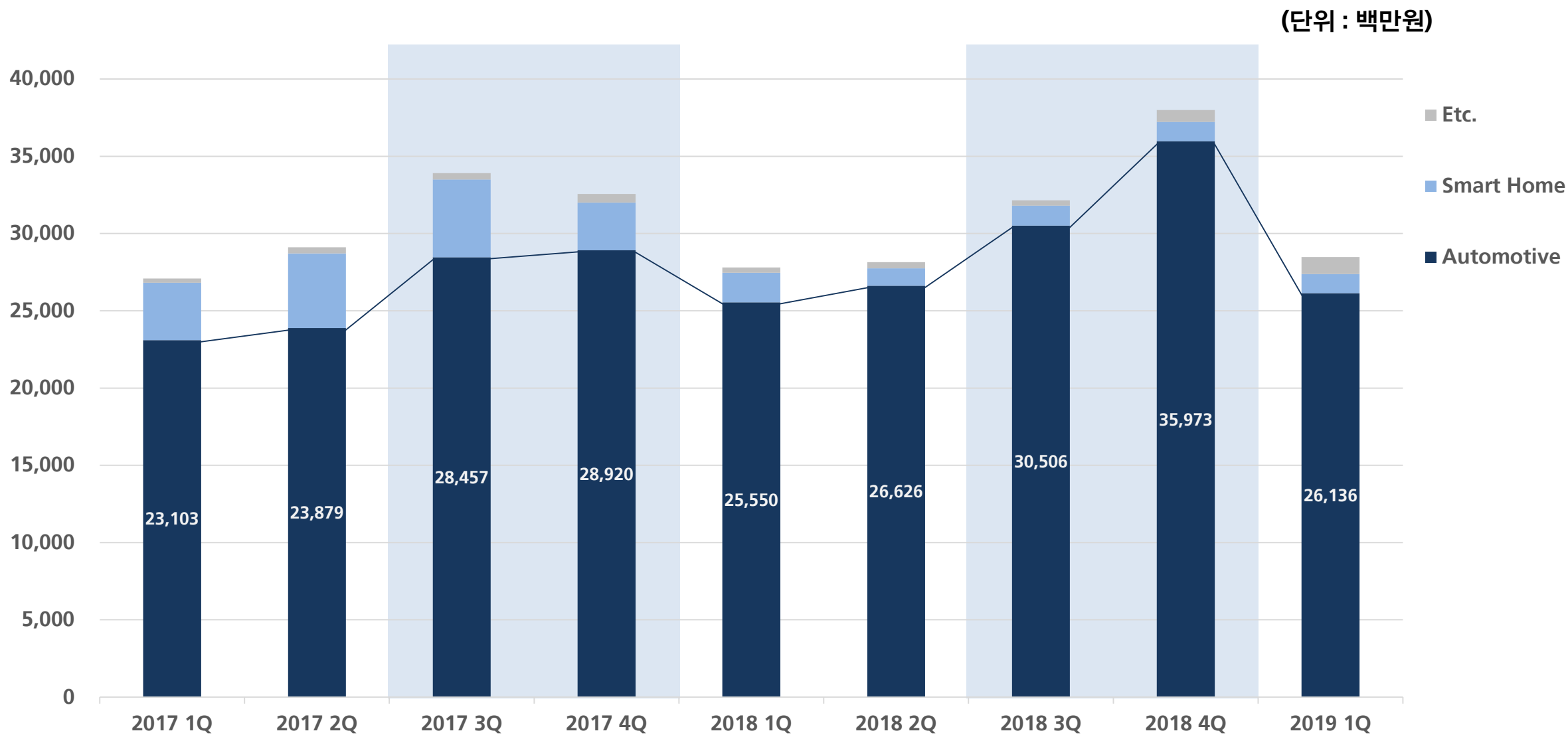


Creation Stage

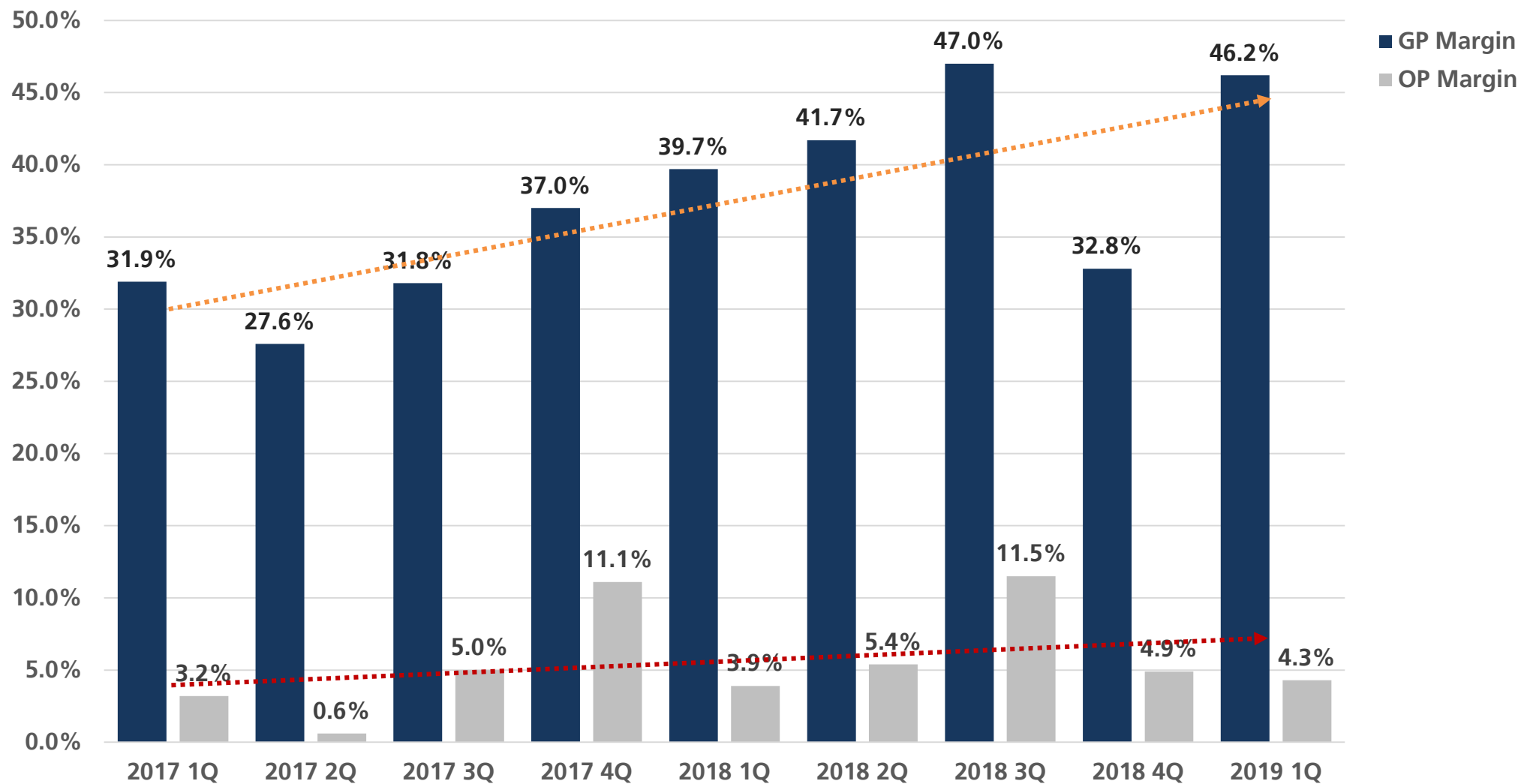
Globalization Stage

Advanced Stage

경영성과 - 매출 현황



경영성과 - 손익 현황



Fabless Company

Creating and Leading Future Technology of Digital Life

설립일 1999년 10월 29일

자본금 6,753 백만원
(2018년말 기준)

인원 총 315명 (R&D: 63.8%, 해외인력 포함)

대표이사 이 장 규

상장 일자 2004년 (KOSDAQ)

제품 Application Processor, Communication IC

사업 영역 **Automotive** (Cockpit / IVI / Cluster / SVM / HUD)
Consumer Electronics (STB / IoT)

설립기

➤ 1999~2000

- 1999 — 텔레칩스 설립
- 2000 — 세계 유일 디지털 Caller ID Chip 개발

Telechips



성장기

➤ 2001~2008

- 2001 — 세계 최초 MP3 Encording 기능 상용화
- 2005 — 세계 최초 'Playforsure'인증 획득
- 2007 — 국내 최초 자동차용 오디오 프로세서 자동차 OEM 공급



정체기

➤ 2009~2014

- 2009 — 세계 최초 Full HD급 멀티미디어 솔루션 출시
- 2013 — 세계 최초 사업자형 Smart Stick 양산 출시

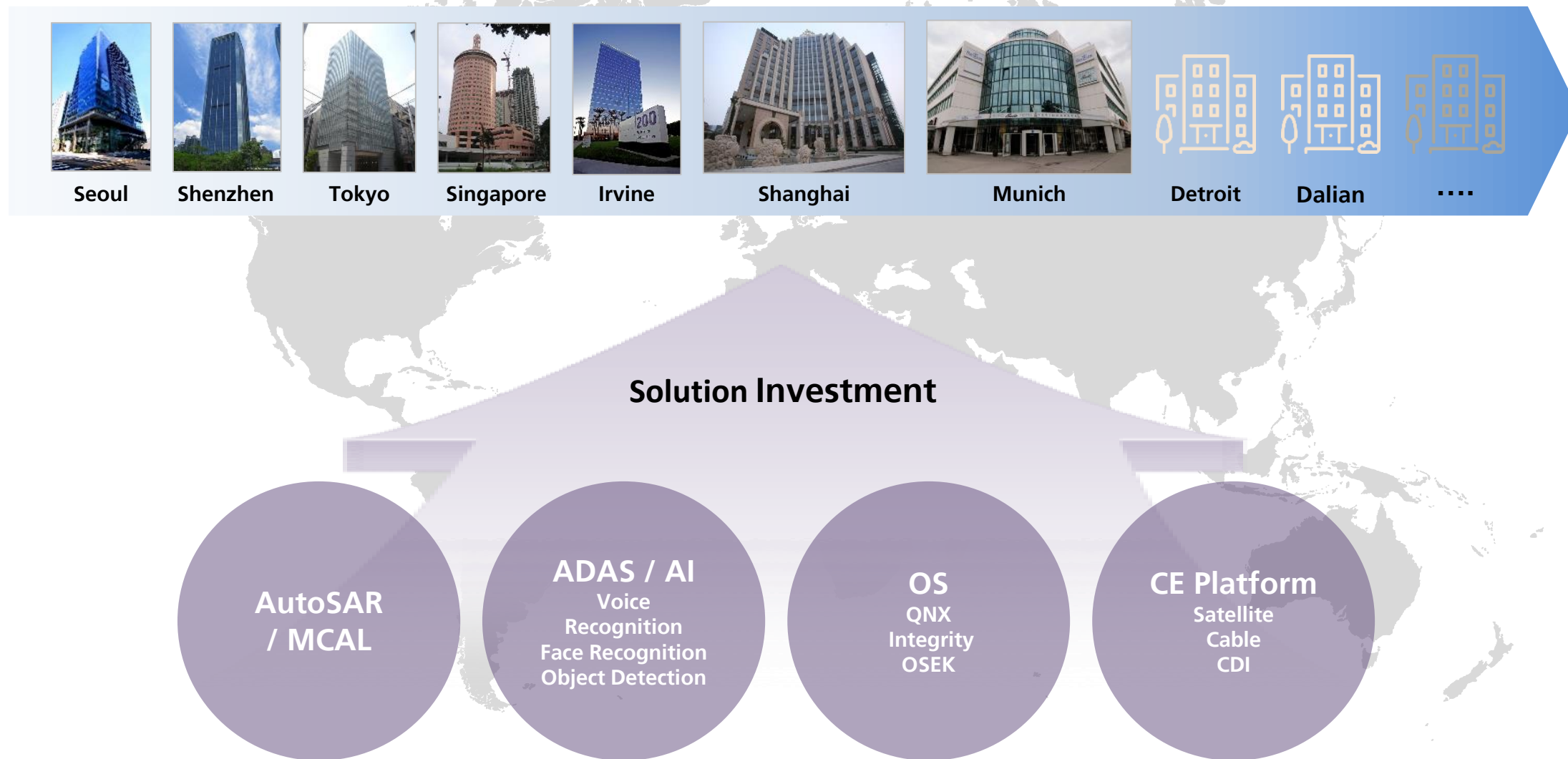


도약기

➤ 2015~현재

- 2015 — 국내 최초 AVN 어플리케이션 프로세서 자동차 OEM 공급
- 2017 — 국내 최초 북미 대형 방송사업자에 STB 어플리케이션 프로세서 공급
- 2018 — 차세대 운전자 보조기술 통합시스템(Cockpit) 출시, 국내 최초 HUD, Digital Cluster 솔루션 출시





요약 연결 재무상태표

(단위: 백만원)

구분	2019 1Q	2018	2017	2016
유동자산	70,189	73,992	75,544	60,917
비유동자산	65,174	63,941	47,619	53,223
자산총계	135,363	137,934	123,163	114,140
유동부채	19,916	23,242	24,055	17,405
비유동부채	18,171	17,696	17,150	16,259
부채총계	38,087	40,939	41,205	33,664
자본금	6,753	6,753	5,315	5,315
주식발행초과금	12,632	12,632	14,082	14,082
기타자본구성요소	(1,460)	(1,651)	(9,297)	(9,924)
이익잉여금	79,351	79,261	71,857	71,003
자본총계	97,276	96,995	81,958	80,476

요약 연결 손익계산서

(단위: 백만원)

구분	2019 1Q	2018	2017	2016
매출액	28,475	126,099	122,667	100,970
매출원가	15,312	75,752	83,163	57,934
매출총이익	13,163	50,347	39,504	43,036
판매비와관리비	11,949	42,192	33,170	36,395
영업이익	1,214	8,155	6,334	6,640
법인세차감전 순이익	1,598	6,237	5	8,980
당기순이익	1,590	9,218	1,541	10,517

Thank You

TeleChips